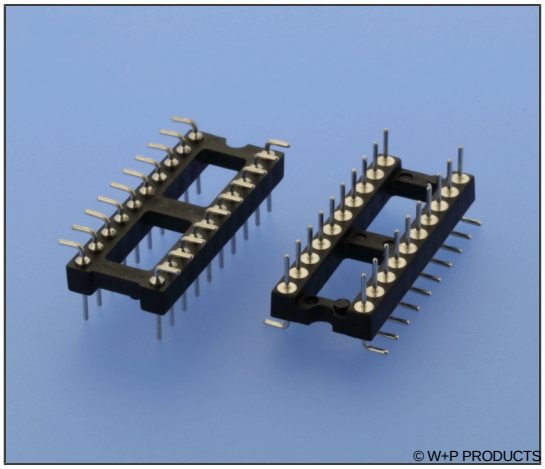
3242

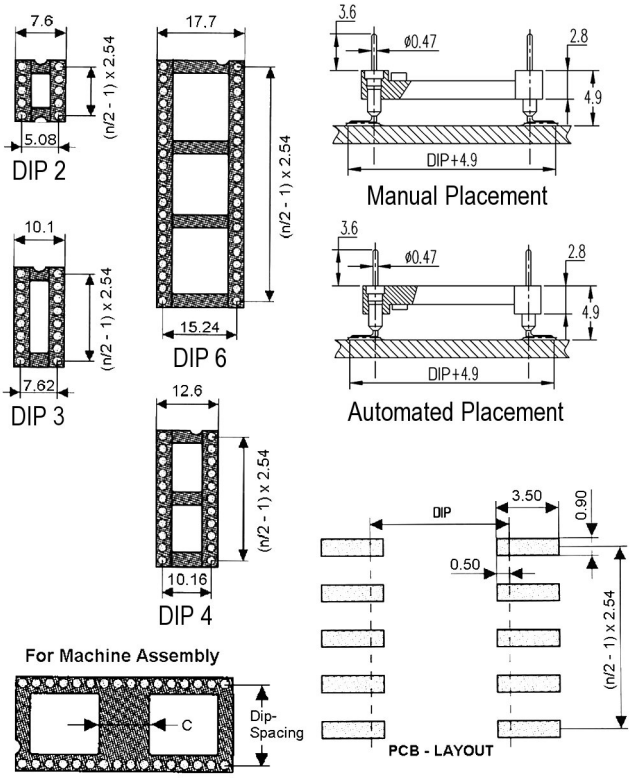
SMT IC-Adapterfassungen RM 2,54mm – Präzisionskontakte in Gull Wing Ausführung

SMT IC Pin Sockets 2.54mm Pitch – Gull Wing Screw machined Contacts

Technische Daten / ***Technical Data***

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	*Reflow soldering*





n	DIP (Code)	DIP [mm]
10	2	5.08
04-10	3	7.62
14-24		
28		
22/24	4	10.16
28		
32		
24	6	15.24
28		
32		
36		
40/42		
48		

Series	*Contacts**	*DIP Spacing**	*Assembly**	*Pin Plating**	*Packaging*	*Leadfree (Optional)**
3242 -	**28**	**4**	**1**	**10**	**ST**	**LF21**
	04/06/08/10/ 14/16/18/20/ 22/24/28/32/ 36/40/42/48 DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle *DIP Spacing options pl. see table*	**2** 5,08mm **3** 7,62mm **4** 10,16mm **6** 15,24mm	**1** Handbestückung *Manual assembly* **2** Automatenbestückung Maß C auf Anfrage *Machine assembly Dim C on request*	**10** 0,25µm Gold *0,25µm gold plated* **50** Verzinnt *Tin plated*	**ST**	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree without RoHS exemption 6c*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** - please replace by your specifications.*

Lieferformen / ***Packaging Options:***
ST Verpackt in Stangen / *Packed in tubes*

Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

